

2012年3月期 第2四半期 決算説明資料

株式会社ディスコ

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

本日のアジェンダ

1.2012年3月期 第2四半期決算概要^{及び}

2012年3月期の見通し

IR室長

小澤 伸一郎

2.事業環境と経営方針

代表取締役会長

溝呂木 齊

3.質疑応答

2012年3月期 第2四半期決算概要及び 2012年3月期の見通し

IR室長
小澤 伸一郎

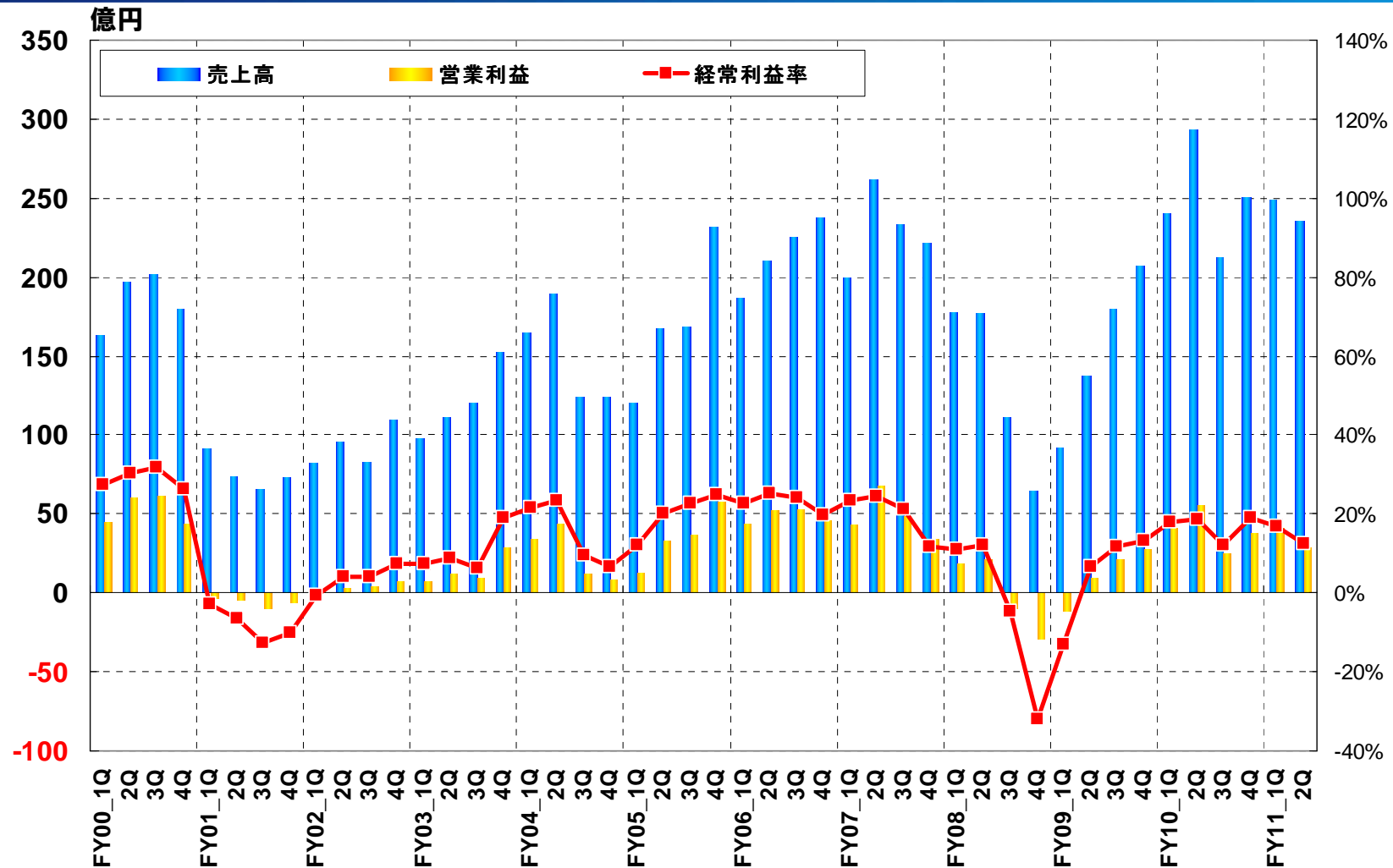
2012年3月期 第2四半期決算概要

(単位: 百万円)

	FY2011	FY2011	比較差異	
	1Q	2Q	差額	(%)
売上高	24,907	23,529	-1,378	-5.5%
売上総利益	11,705	10,770	-935	-8.0%
GP率	47.0%	45.8%	-1.2p	-
販売管理費	7,629	7,946	317	4.2%
営業利益	4,076	2,824	-1,252	-30.7%
経常利益	4,155	2,954	-1,201	-28.9%
経常利益率	16.7%	12.6%	-4.1p	-
税前利益	4,163	2,917	-1,246	-29.9%
純利益	2,513	2,216	-297	-11.8%
減価償却費	1,355	1,443	88	6.5%
研究開発費	2,252	2,531	279	12.4%

- 売上高は前四半期と比べて若干減少したものの、底堅く推移した
- 円高の進行などにより、GP率は前四半期比1.2ポイント低下し45.8%となった
- 営業利益率は、研究開発費など販売管理費の増加が影響し12.0%に留まった

連結業績 四半期推移

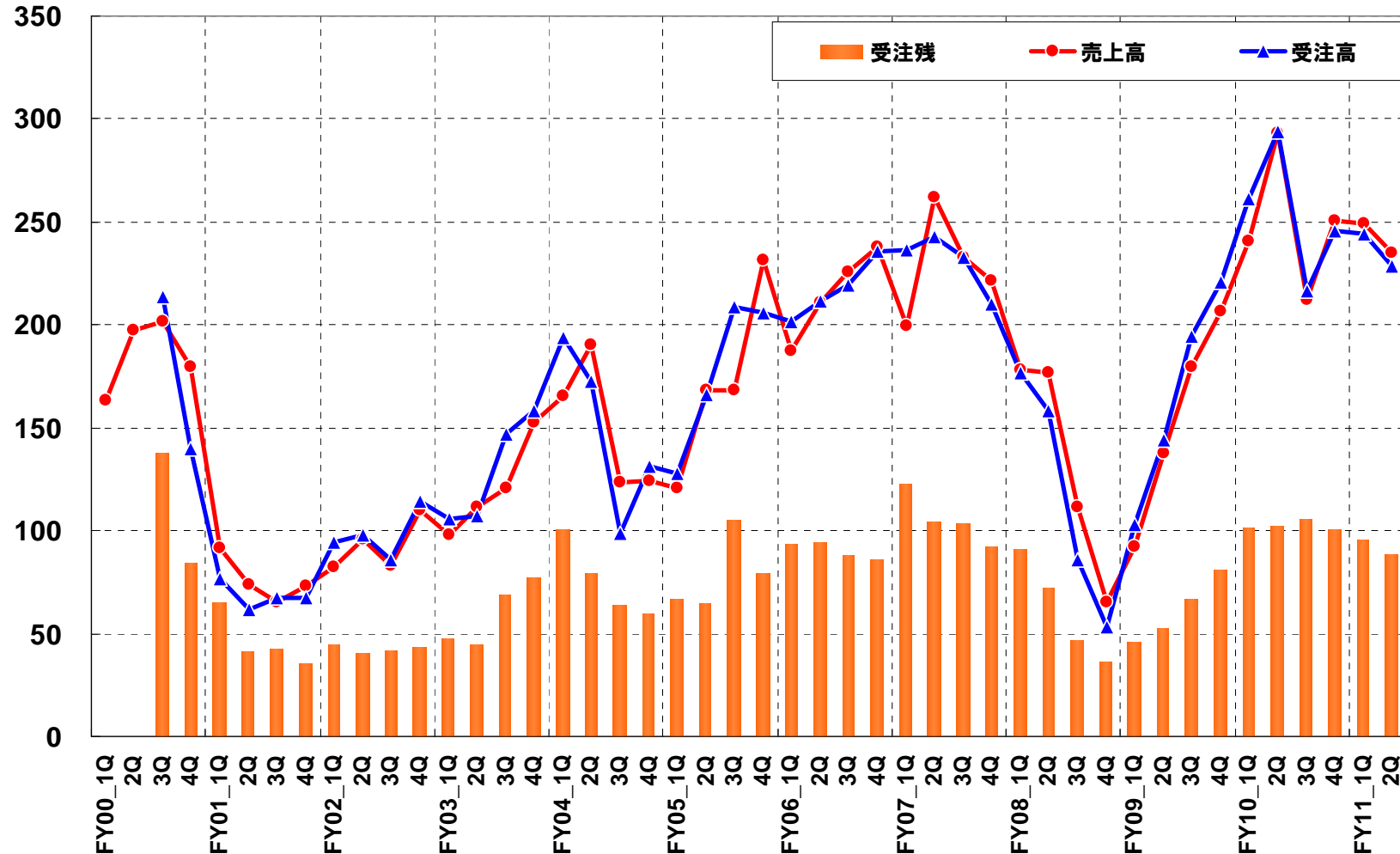


- FY11_2Qの売上高は、前四半期からわずかに減少したものの、比較的高い水準
- FY11_2Qの経常利益率は12.6%となり、前四半期から4.1ポイント低下した

連結売上高・受注高 四半期推移

億円

注: 2000年度第3四半期より四半期決算開示

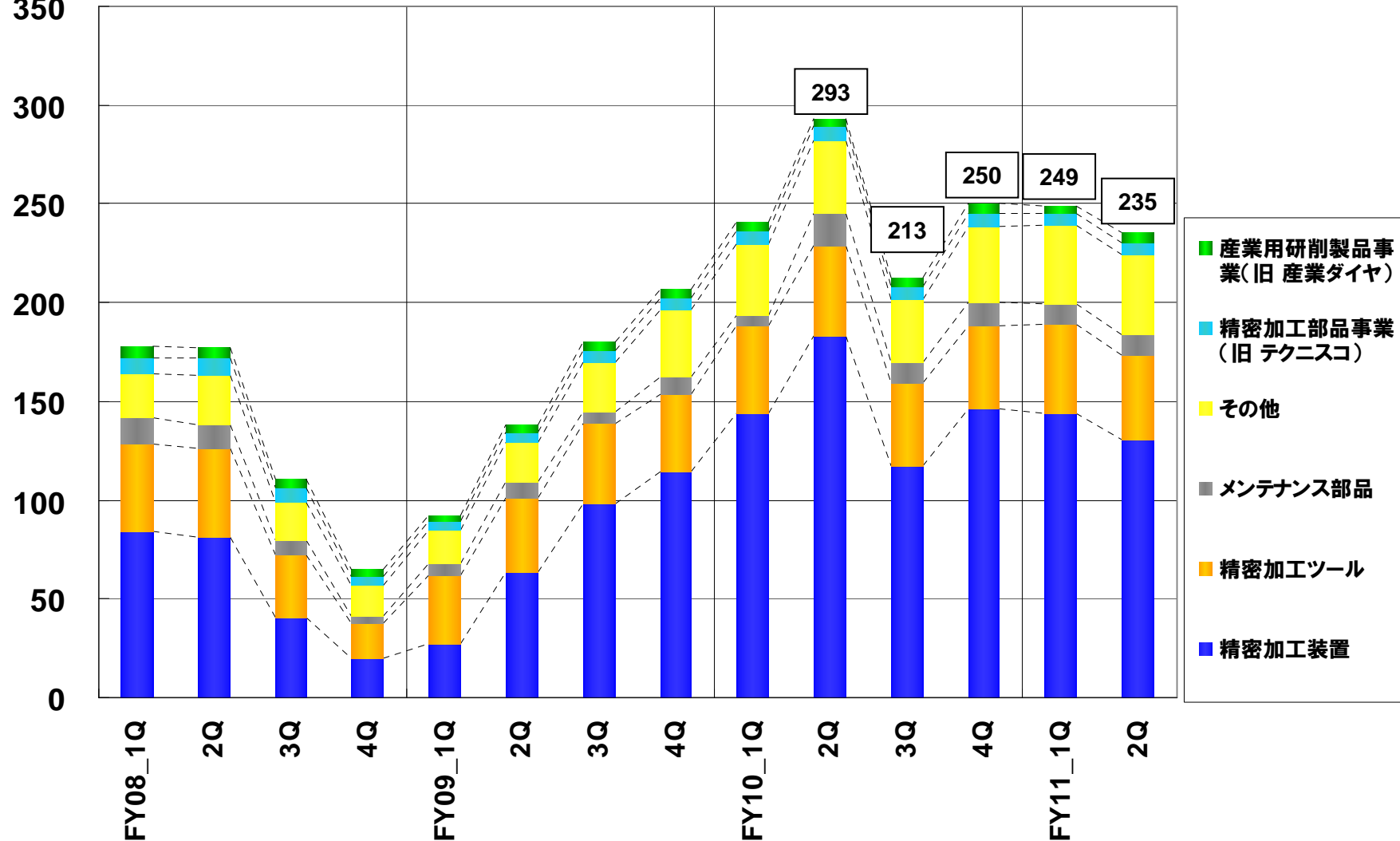


【2011/11/15 訂正】

- 連結受注高は市場全体の減速の影響を受け、前四半期比6%減の228億円となり、受注残は減少し89億円となった

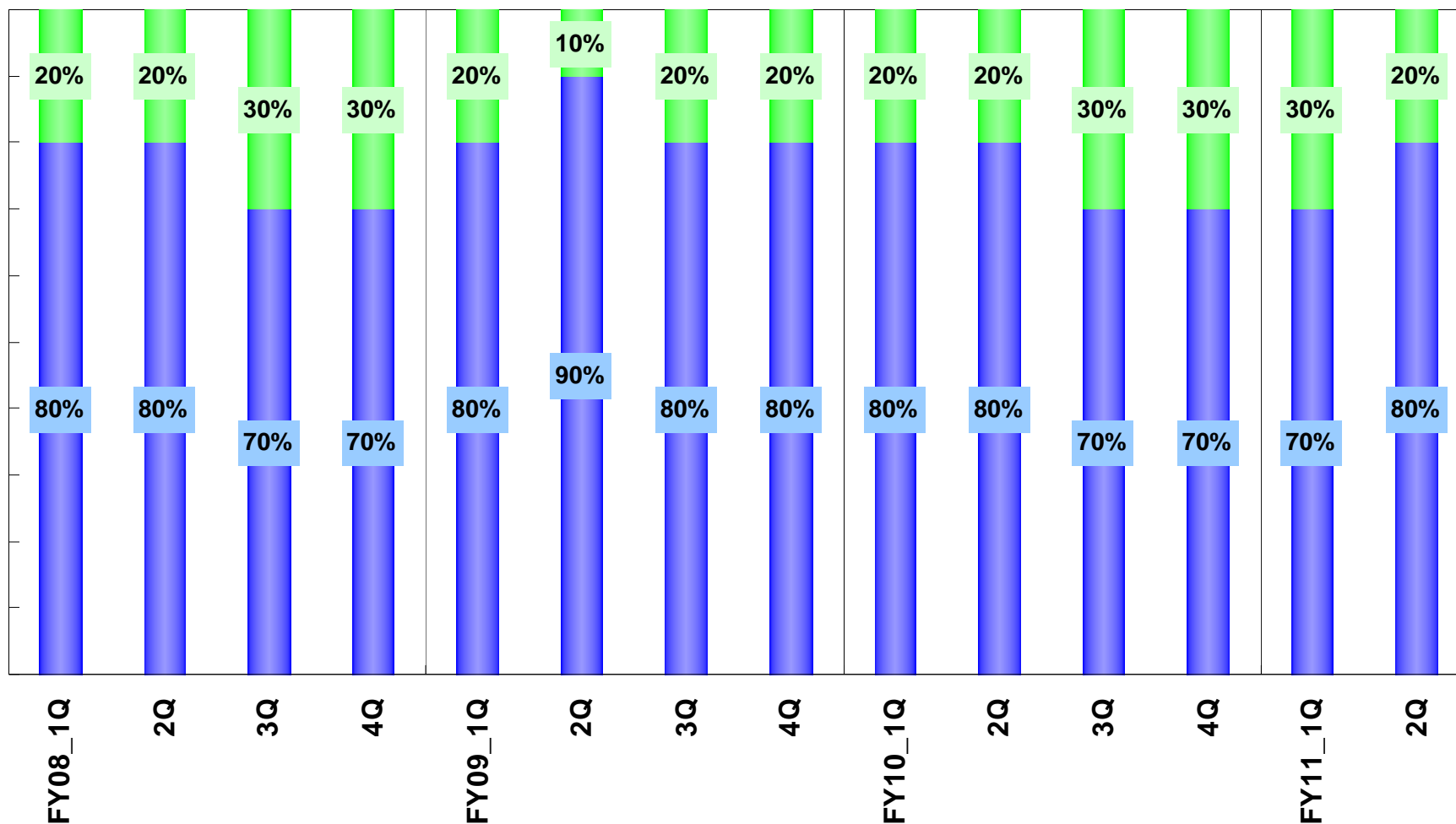
連結売上高 製品群別構成 四半期推移

億円 350



- 『精密加工装置』の売上高は前四半期比で1割弱の減少
- 前四半期に対し、『産業用研削製品事業』『その他』の売上高は微増となった

精密加工装置 構成比概数 四半期推移



■ 精密切断装置
(ダイシングソー、レーザーなど)

■ 精密研削・研磨装置
(主にグラインダ)

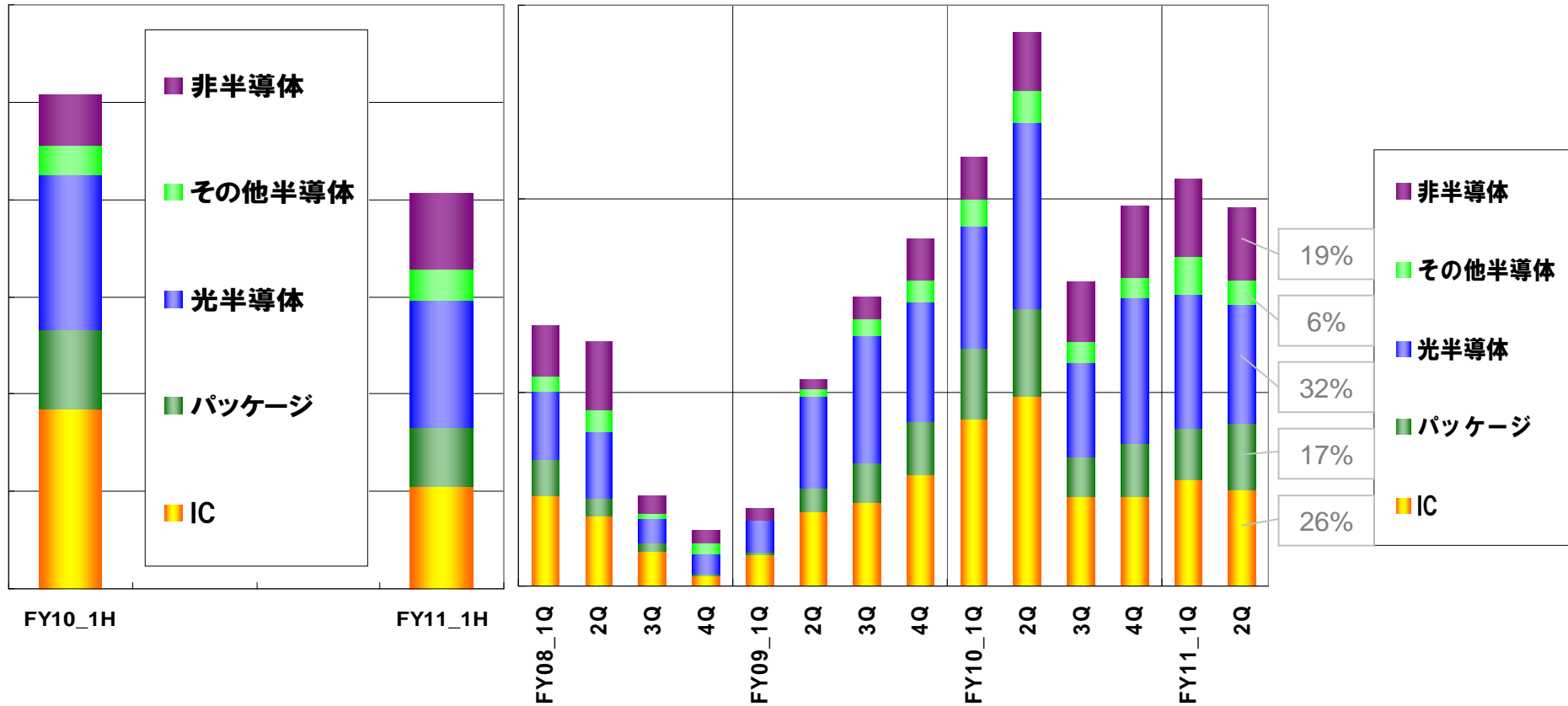
- 精密加工装置の比率はダイサ8：グラインダ2となった
- FY11_2Qは、精密切断装置のうちダイシングソーとレーザーの比率は8：2となった

【精密加工装置】

精密切断装置* 売上構成 (アプリケーション別・単体)

前年同期比較

注：精密加工装置
ダイシングソー、レーザーソー、他



- 過去最高であったFY10_1Hに対し、FY11_1Hの精密切断装置の売上高は2割減少した
- スマートフォン需要により、非半導体（主に電子部品）の構成比は上期YoYで大きく増加し約20%となる
- 四半期推移では、光半導体向け（主にLED）が微減となった一方、パッケージ向けは改善した

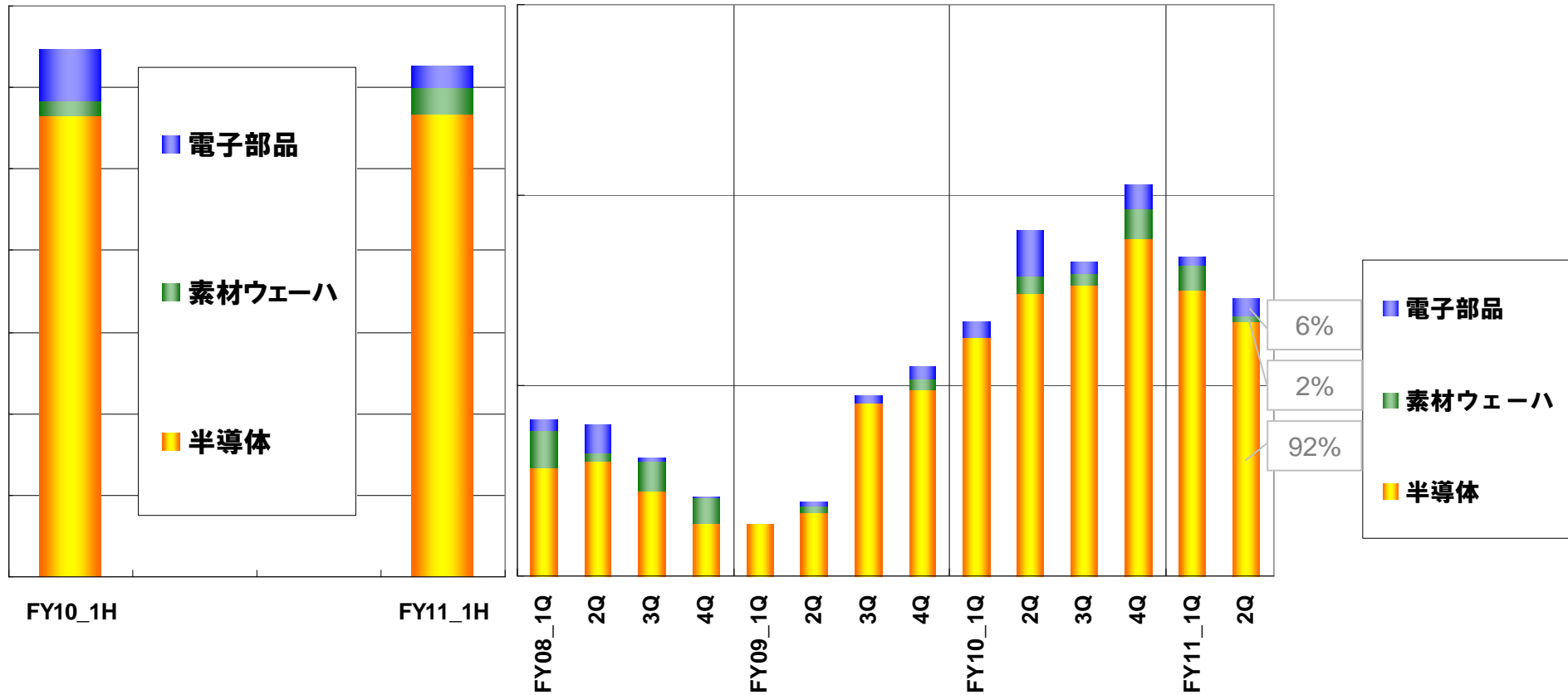
【精密加工装置】

精密研削・研磨装置* 売上構成 (アプリケーション別・単体)

前年同期比較

注：精密研削・研磨装置

グラインダ、ポリシャ、グラインダポリシャなど

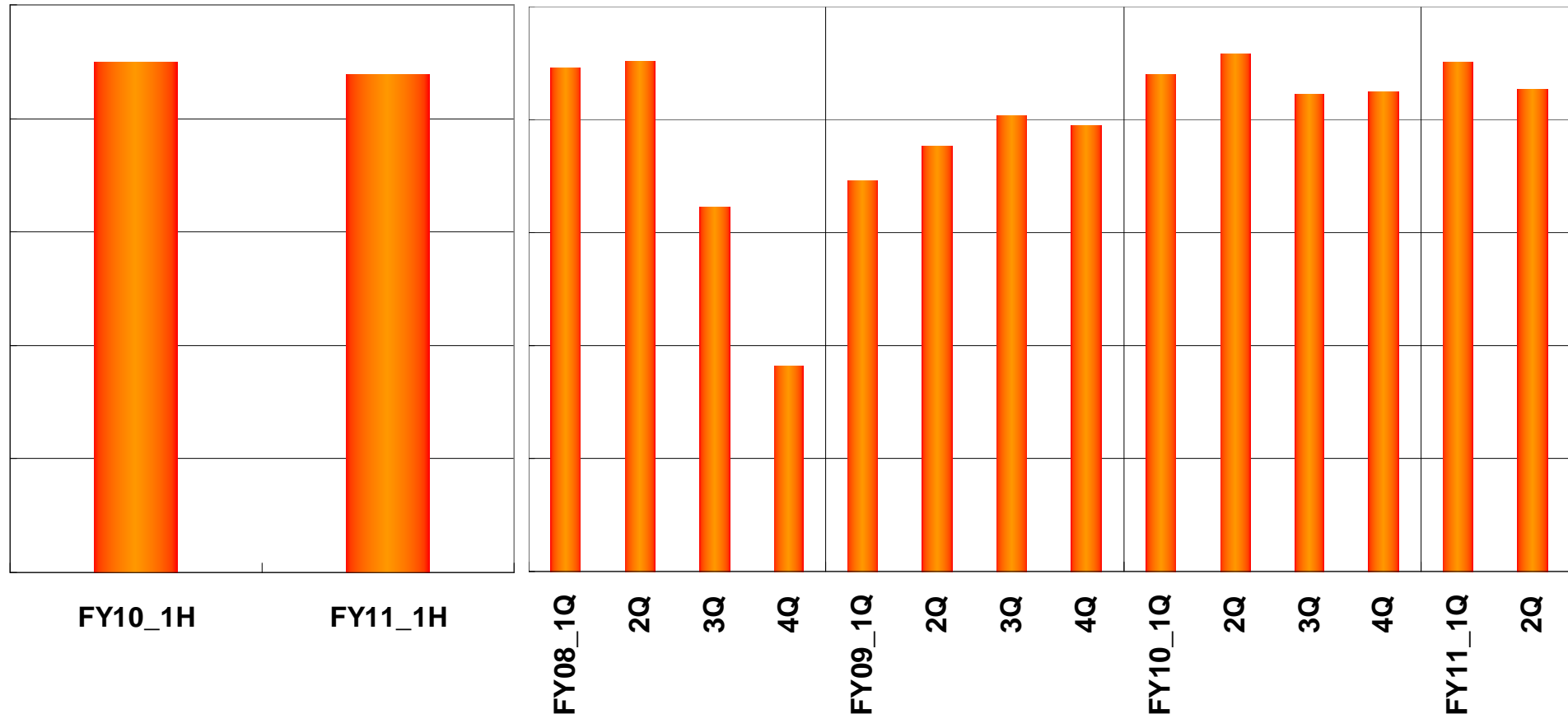


- 『半導体』に含まれるメモリ用薄化装置の出荷が好調に推移し、FY11_1Hの売上高はFY10_1Hに対して同水準となった
- 四半期推移では、薄化用途以外で『半導体』向け製品の出荷が一時的に落ち込み、全体の売上高がQoQで約1割の減少となった

精密加工ツール* 売上高推移 (連結)

前年同期比較

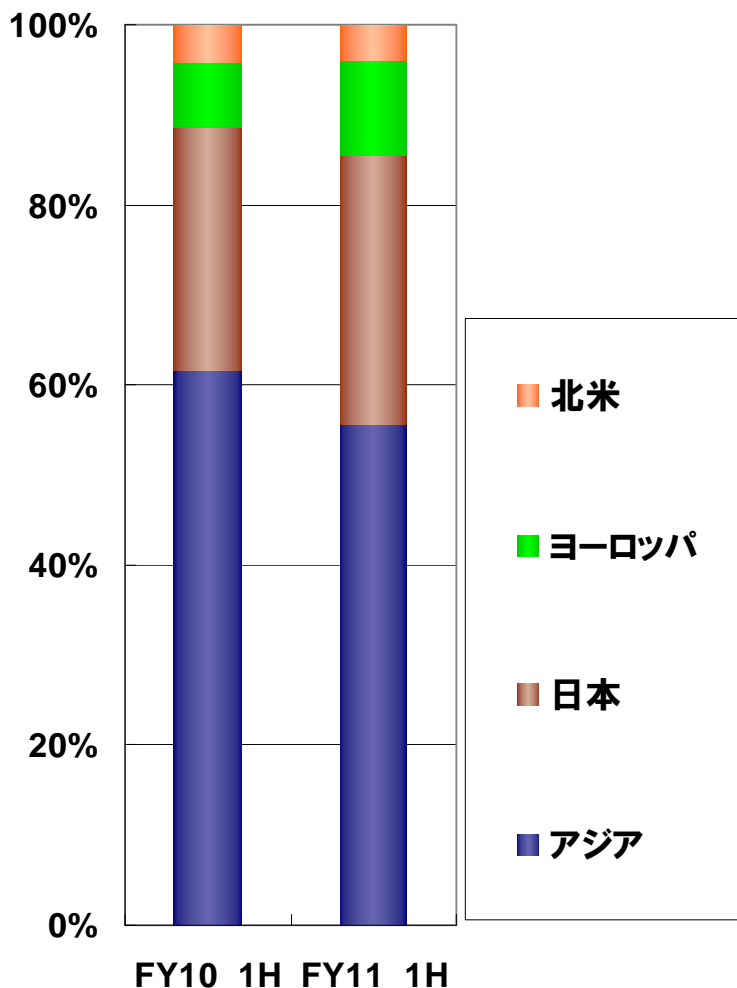
注：精密加工ツール
ダイシングブレード、グラインディングホイール、
ドライポリッシングパッド他



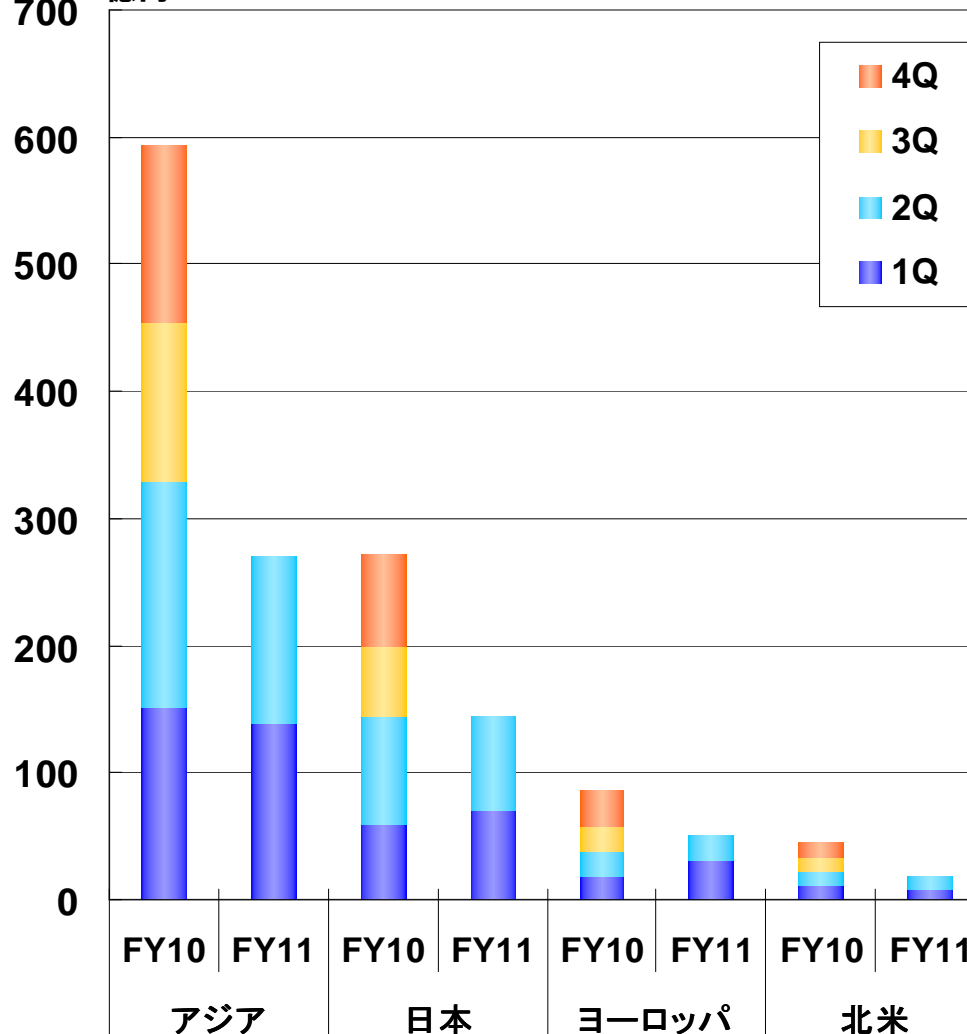
- 円高の影響はあったものの、販売数量は堅調に推移し、FY11_1Hの売上高はYoYでほぼ横ばいとなった
- 四半期推移では、震災特需のあった前四半期と比べると売上高は減少したものの、依然として高い水準となった

地域別売上高 前期比較(連結)

構成比

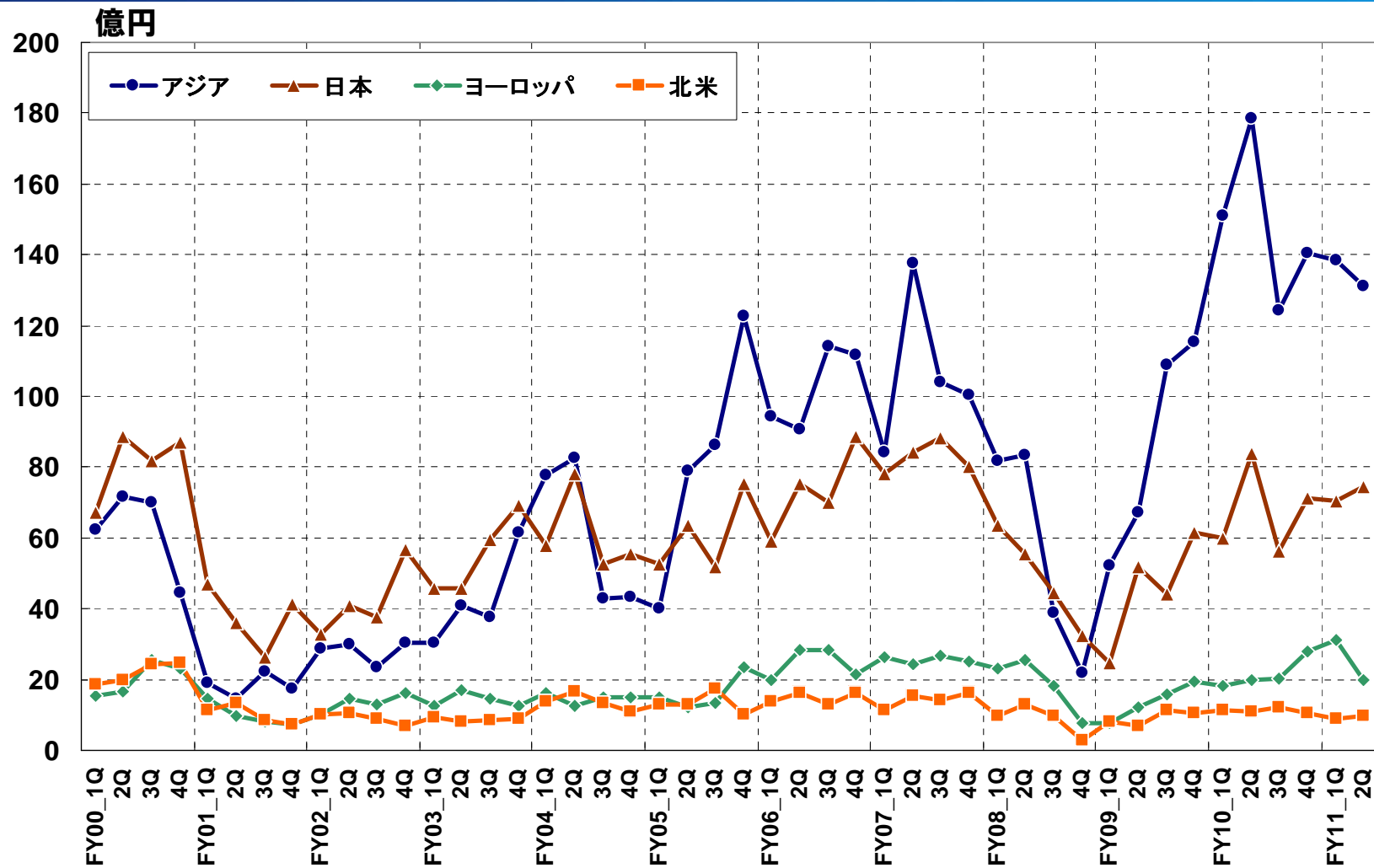


売上高 700 億円



- 台湾をはじめとするアジア地域では、多くのアプリケーションで設備投資意欲が減退したことから、その構成比は上期比較で減少に転じた
- 国内は比較的底堅い販売推移となったほか、ヨーロッパ地域も堅調な売上高を計上した

地域別売上高 四半期推移(連結)



- 前四半期に対し、アジア・ヨーロッパ地域は減少に転じた一方、国内はわずかだが伸長した
- FY11_2Qでは、アジア地域のうち台湾・中国・韓国の3カ国が約8割を占めた

バランスシート(抜粋) 前期末比較

(単位: 百万円)

	FY2010 4Q	FY2011 2Q	差額
流動資産	77,778	77,945	167
現預金	20,314	22,368	2,054
受取手形・売掛金	28,322	25,456	-2,866
たな卸資産	23,777	26,832	3,055
固定資産	61,444	62,073	629
有形・無形固定資産	54,283	53,929	-354
資産合計	139,240	140,034	794
負債合計	41,606	39,731	-1,875
流動負債	29,355	27,507	-1,848
固定負債	12,251	12,224	-27
純資産合計	97,633	100,303	2,670
自己資本比率	69.4%	70.9%	+1.5p
負債・純資産合計	139,240	140,034	794

【3月末 9月末 比較】

- 資産：売上債権の回収に伴い受取手形・売掛金が減少した一方、現預金やたな卸資産、工場新棟の建設仮勘定などで総資産は若干増加
- 負債：主に未払い法人税が減少
- 純資産：利益剰余金の増加 自己資本比率は1.5ポイント増加し70.9%

キャッシュフロー(抜粋)

(単位: 百万円)

	FY2010 1H	FY2011 1H	差額
営業キャッシュフロー	9,295	8,268	-1,027
税前純利益	9,589	7,081	-2,508
減価償却費	2,830	2,799	-31
売上債権・たな卸資産・仕入れ債務	-5,942	1,497	7,439
法人税・その他	2,818	-3,109	-5,927
投資キャッシュフロー	-1,700	-3,887	-2,187
有形固定資産の取得による支出	-3,989	-3,120	869
その他	2,289	-767	-3,056
財務キャッシュフロー	-2,832	-1,449	1,383
借入返済等による支出等	-3,000	-124	2,876
配当金の支払額	-337	-1,345	-1,008
その他	505	20	-485
フリーキャッシュフロー	7,594	4,381	-3,213
現金および現金同等物の増加額	4,371	2,097	-2,274
現金および現金同等物の期末残高	19,618	21,928	2,310

- 営業CF 売上債権・たな卸資産・仕入れ債務が資金増に転じたことで82億円の資金増加
- 投資CF 呉C棟建設など有形固定資産の取得により39億円の資金減少
- 財務CF 主に配当金の支払いにより14億円の資金減少
- フリー・キャッシュ・フローは43億円、現金および現金同等物の期末残高は約220億円となった

2012年3月期通期 連結業績見通し

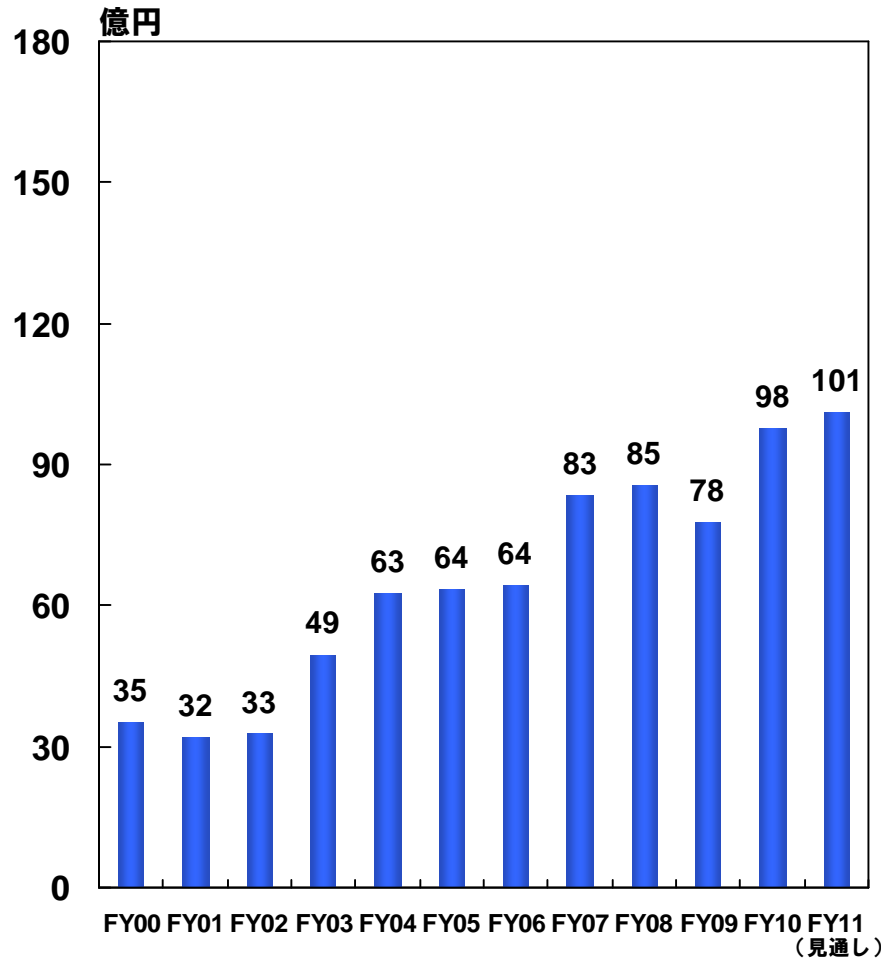
(単位: 億円 四捨五入)

	FY2011					ご参考	
	1Q 実績	2Q 実績	上期 実績	下期 予想	通期 予想	前回予想 (通期)	今回 修正額
売上高	249	235	484	409	893	971	-78
営業利益	41	28	69	32	101	142	-41
経常利益	42	30	71	32	103	143	-40
経常利益率	16.7%	12.6%	14.7%	7.8%	11.5%	14.7%	-3.2p
純利益	25	22	47	16	63	91	-28
設備投資	22	10	32	54	86	84	2
減価償却費	14	14	28	34	62	65	-3
研究開発費	23	25	48	53	101	99	2

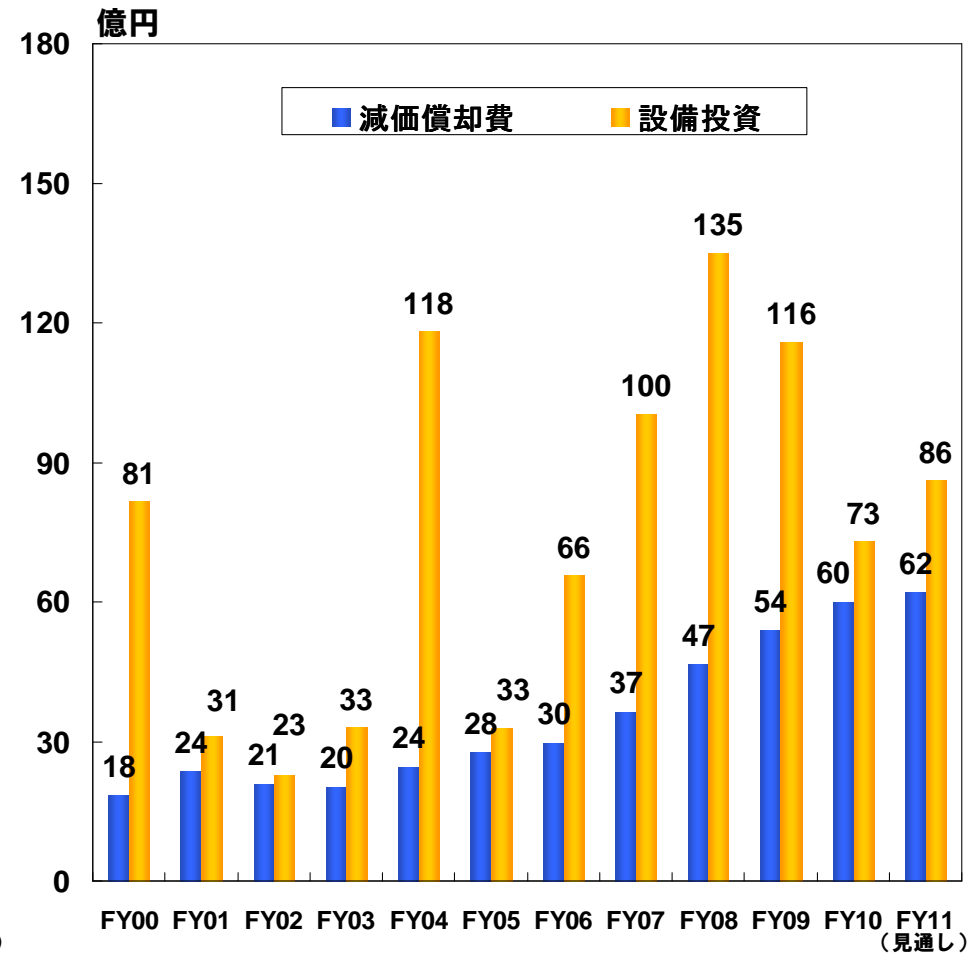
- 市場全体の減速感を反映し、アジア地域を中心に設備投資抑制の動きが顕著なため連結業績見通しを修正する
 - アジア地域では、サブコン各社および台湾LEDメーカーが、それぞれ投資計画を大幅に見直した
 - 国内においては、主にブレードダイサの生産計画を下方に修正した
 - 精密加工ツールは客先の生産数量の見直しに合わせ、その見通しを若干減少させた
- 想定為替レート US\$: 75円 / Euro : 100円
 • 為替1円あたり影響額 (単体・年換算) US\$: 368百万円 / Euro : 18.7百万円

連結 研究開発費/設備投資見通し

研究開発費



減価償却費・設備投資



- 研究開発費は前回予想時から増額し、100億円を超え過去最高となる見通し（8月予想からプラス2億円）
- 減価償却費は、見通しを下方に見直した（8月予想からマイナス3億円）

配当政策および配当額

(単位:円)

FY2011	中間期	期末	年間
前回予想	27	28	55
今回予想	29	10	39
修正額	2	-18	-16

FY2010	中間期	期末	年間
実績	25	40	65

【配当方針】 ※平成23年2月23日開催の取締役会にて一部変更

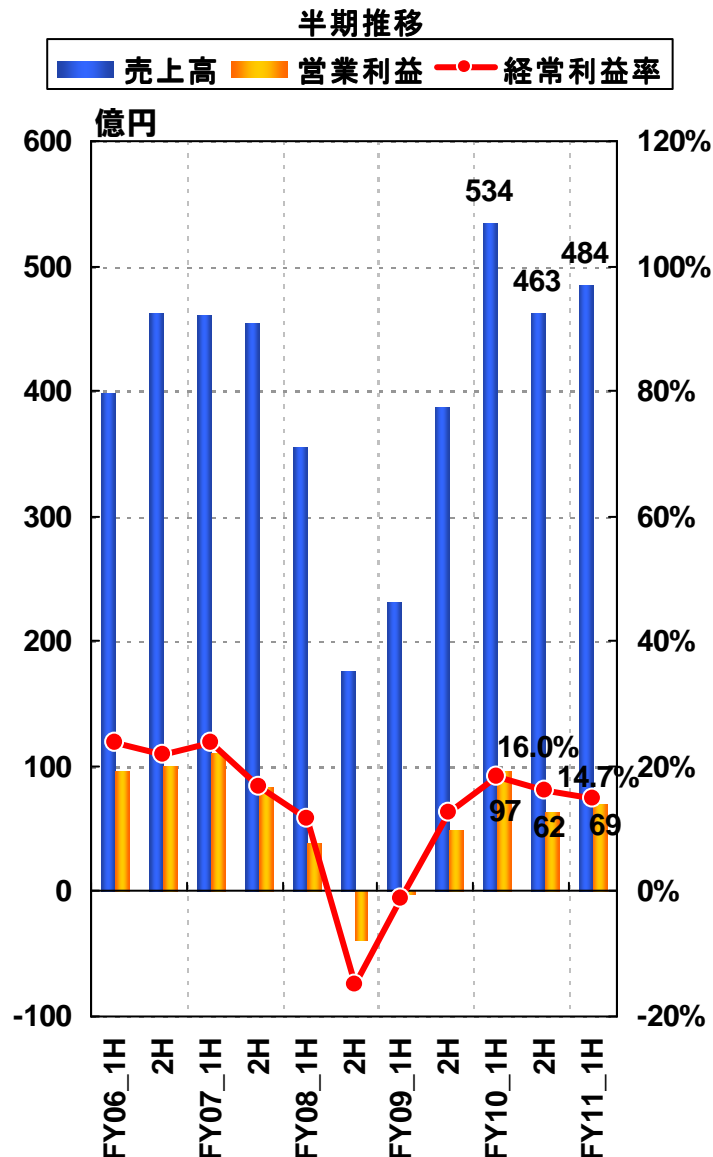
1. 期末,中間の年2回、連結半期純利益の20%を配当する
2. 安定配当として半期10円(年間20円)を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 4年累計で連結売上高経常利益率が20%を達成した場合、連結当期純利益の24%という配当性向を適用し、期末配当で中間配当の差額分を配当することとする
4. 期末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする

*技術資源購入資金(技術特許購入、ベンチャーへの出資等)および設備拡張資金、有利子負債返済資金など

事業環境と経営方針

代表取締役会長
溝呂木 齊

事業環境と当社事業: 2011年度上期サマリー



2011年度上期の当社事業について

□ 売上高は高水準を維持し、8月対外発表業績予想通りの着地となる（半期では過去2番目の売上高）

□ 円高進行による収益圧迫の影響を大きく受け、経常利益率は低下

スマートフォン関連の設備投資が活発で、当社のKKMソリューションが幅広い顧客ニーズに合致（電子部品向けブレードダイサ、メモリ向け薄化グラインダ）

□ 薄化技術ニーズの進展によりDBG※装置（主に3軸グラインダ）および、これに使用される精密加工ツールの売上が堅調に推移 ※DicingBeforeGrinding

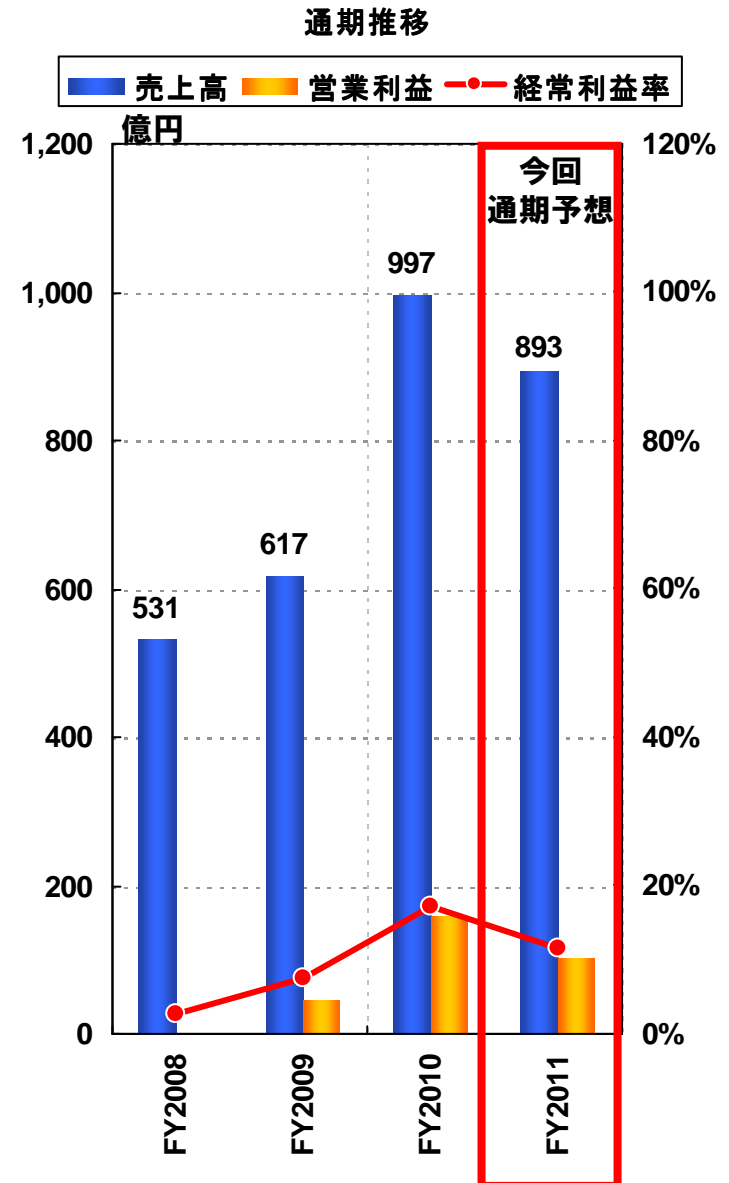
2011年度の事業環境

●2011年度の見通し

事業環境について

- 半導体市場は悪化局面にあるが、08年の「底の见えない」需要蒸発という状況とは異なる
- 最終製品需要の落ち込み
(PCの伸び悩み、LED TVなど)
→アジア地域の設備投資抑制
(サブコン各社・LEDメーカーなど)
- スマートフォン関連メーカーでは、高い稼働状況が続く
- 次世代技術への先行投資を継続的に実施
 - TSV (ThroughSiliconVia)
 - BSI (Backsideillumination)
 - パワーデバイス

通期 売上高 893億円 (FY10比 10.5%減)
 営業利益 101億円 (FY10比 36.7%減)



おわりに

変化に速やかに対応出来るシンプルかつ有機的な組織になっていく

- より能動的な組織へ変革していく

先端技術ニーズへの対応

- 新規アプリケーションへの研究投資
- 新製品開発に継続して注力する

拠点アプリケーション力の向上

- シンガポール、台湾、中国、ほか

市場動向に合わせた柔軟な事業経営

- 生産対応力・サプライチェーンの強化
- 経費削減活動の継続・管理の徹底...経費管理レベルを“C”から“D”へ変更



本社R&Dセンター 新棟 アプリケーションラボ

DISCO

Kiru · Kezuru · Migaku Technologies

